

### Materiales, grosores y espesores de Cu

BICAPA		0,25 mm	0,35 mm	0,5 mm	0,8 mm	1 mm	1,2 mm	1,6 mm	2 mm	2,4 mm	3,2 mm
FR4	35 $\mu$	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	70 $\mu$	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	105 $\mu$	No*	No*	No*	No*	No*	No*	Sí	Sí	Sí	No*
CEM-3	35 $\mu$	No	No	No	No	Sí	No	Sí	No	No	No
ROGERS 4003	35 $\mu$	No <sup>1</sup>	No <sup>1</sup>	Sí	Sí	No <sup>1</sup>	No <sup>1</sup>	No <sup>1</sup>	No <sup>1</sup>	No <sup>1</sup>	No <sup>1</sup>
ROGERS 6002	<i>Material aportado por el cliente</i>										
TEFLON	<i>Material aportado por el cliente</i>										

\* Consultar. Otros espesores de cobre final pueden estar disponibles.

<sup>1</sup> Material no disponible. Posible fabricación si lo aporta el cliente

- Todos los espesores de cobre se refieren a "cobre final".
- Dependiendo del diseño del circuito, grosor pista mínimo, descompensaciones grandes de cobre entre capas o entre zonas del circuito, etc., algunos espesores de cobre no se podrán fabricar.

### Características de fabricación

BICAPA	CLASE III	CLASE IV	CLASE V
Ancho / espacio entre conductores / espesor cobre base	0,3mm /0,3mm /18 $\mu$ 0,3mm /0,3mm /35 $\mu$ 0,35mm/0,35mm/70 $\mu$	0,2mm/0,2mm/18 $\mu$ 0,25mm/0,2mm/35 $\mu$	0,15mm/0,15mm/18 $\mu$
Diámetro mínimo taladro metalizado	0,5mm	0,4mm	0,3mm
Corona mínima	0,22mm	0,18mm	0,15mm
Aspect/Ratio	6	6	6
Margen máscara antisoldante	0,15mm	0,1mm	0,075mm